

ASML

Field Application Engineer Scholarship

대학원(석사) 장학 프로그램

ASML Korea 장학 프로그램은 이공계열 우수 석사 학생을 지원하여 미래 반도체 분야의 리더를 양성하기 위한 프로그램입니다.



모집대상 및 자격요건

- 졸업조건: 2025년 2월 석사 졸업 예정자
- 전공: 전기전자, 기계, 물리, 광학, 반도체공학
- 평균 성적: 3.5 / 4.5 이상
- 2024년 2학기 연속적으로 재학 가능한 자
- 프로그램 활동에 제약없이 참석 가능한 자
(수여식, 멘토링 프로그램, Case Study 발표 등)



장학제도 및 상세 내용

- 2024년도 한 학기당 250만원 지원, 총 2 학기 지원
- 프로그램 성적 우수자에 한해 ASML Korea 채용 전형의 최종 면접 기회 제공
- 선배와의 만남, 리더쉽 및 멘토링 프로그램, Case Study를 통하여 ASML 업무에 대한 이해와 전공 연계성 확보 가능
- *타 기업 장학금 중복 수혜 불가 (교내 장학금은 가능)



지원 기간 및 방법

- 지원기간: 2024년 1월 29일(월) ~ 2월 12일(월)
- 지원 링크: <https://asmilkorea.recruiter.co.kr/app/jobnotice/view?systemKindCode=MRS2&jobnoticeSn=169319>



- 국문 자기소개서
- 필수 제출 서류 :
 - 1) 학사 졸업증명서, 석사 재학증명서 각 1부
 - 2) 성적증명서(학사성적, 석사 직전학기 포함) 각 1부
- *지원서 내용에 허위사실이 판명될 경우 합격이 취소될 수 있습니다.
- *기존의 지원자 분들에게는 순차적으로 결과를 전달드릴 예정입니다.



전형절차



문의처

- ASML Korea 인사팀 'ASML 장학생 프로그램' 담당자
- e-mail : korearecruit@asml.com

Field Application Engineer

직무소개

Field Application Engineer 는 Photo lithography와 반도체 공정에 대한 높은 이론적 지식을 바탕으로 customer wafer product에서 발생하는 복잡한 이슈들을 분석, 해결방안을 고객, 본사에 제시하는 역할을 수행하고, 새로운 앞선 어플리케이션을 제공함으로써 더 나은 성능의 ASML 시스템 개발을 리드합니다.

Fab Support Engineer

기술 분야의 제너럴리스트로서 고객 공정에서 발생하는 전반의 문제해결 및 ASML product 과 서비스 성능 극대화를 위한 솔루션을 제시

YieldStar Competency

고객 요건에 따라 기술적인 솔루션 제시, YieldStar metrology utilization 최대화 및 Metrology 시스템의 검증

Twinscan Competency (Overlay / Imaging / Productivity)

- Overlay : Overlay application의 효과적인 사용을 위한 기술지원, 에스컬레이션, 기술적 지식 전달, 스캐너 성능 최적화를 위한 솔루션 제공
- Imaging : Imaging application의 효과적인 사용, 고객사 공정상의 imaging과 focus관련 이슈 해결 및 평가
- Productivity : 제품의 성능과 생산성 향상을 위해 product condition에 따른 wafer per day의 영향을 예측 및 손실을 정량적으로 분석

Patterning & Control Competency

고객의 Node transition project와 관련하여 최적화된 패턴화 솔루션 제시, 기술적인 인풋 프로젝트/제품 팀에 요구사항을 전달 및 고객의 패턴닝 환경에서 제품 성능 구현

